

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2010-014

南通富士通微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的有关规定，现将本公司截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192号文核准，本公司于2007年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，发行价为每股8.82元。截至2007年8月7日，本公司共募集资金59,094万元，扣除发行费用2,659.52万元后，募集资金净额为56,434.48万元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2007）第042号验资报告验证。

本公司募集资金净额56,434.48万元到位后已直接存入募集资金专户。截至2009年12月31日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司南通青年路支行	1111820129100291893	募集资金专户	8,392,884.85
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	32001642736059588588	募集资金专户	10,599,877.65
中国银行股份有限公司南通分行	15807008406001	募集资金专户	15,863,764.80
江苏银行股份有限公司南通崇川支行	89011015201010088886	募集资金专户	4,779,584.66
合计			39,636,111.96

上述账户截至2009年12月31日余额为3,963.61万元，其中，募集资金余额为3,282.65万元，账户派生利息净收入680.96万元。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况与前次招股说明书中关于募集资金运用的相关披露内容进行逐项对照

详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

说明：

1、截至2009年12月31日，本公司四个募投项目尚未投入的募集资金为11,790.89万元，包括募投项目拟投入的流动资金8,603.00万元。可使用的资金如下（单位：万元）：

项 目	金 额（万元）
募集资金专户存储（扣除利息净收入680.96万元）	3,282.65
信用证保证金账户存款	2,908.24
待收回的暂时补充流动资金	5,600.00
募投项目可使用资金	11,790.89

2、在信用证到期后，上述2,908.24万元信用证保证金将转为实际支付，本公司以募集资金投入募投项目的固定资产投资将达到33,360.35万元。与招股说明书中披露的固定资产投资33,640万元相比，结余募集资金279.65万元。

3、暂时补充流动资金于2010年1月12日到期归还后，本公司将根据招股说明书披露的投资计划和2008年调整的预计年度投资进度，连同募集资金专户中存储余额投入募投项目流动资金8,603.00万元。

(二) 前次募集资金投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目转让或置换情况。

(四) 募集资金超过原预计募集资金使用情况

根据公司2007年8月23日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》，本公司将实际募集资金净额超出募投项目投资总额422,430,000元部分的141,914,800元用于补充公司流动资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2008年8月1日第二届董事会第二十一次会议、2009年1月16日第三届董事会第三次会议、2009年7月14日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

其他用途	使用闲置资金（万元）	使用时间	收回情况
补充流动资金	5,600.00	半年	2009年1月15日收回
补充流动资金	5,600.00	半年	2009年7月10日收回
补充流动资金	5,600.00	半年	2010年1月12日收回

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

本公司功率IC项目和微型IC项目实际效益未达到预计效益的80%以上，原因如下：

1、金融危机影响

受金融危机影响，近两年（尤其是2008年第四季度和2009年第一季度）集成电路终端消费需求低迷，行业增长放缓，市场竞争加剧，产品价格降低。同时，造成公司订单减少，募投项目产出低于预期。

2、实际投资进度未达到计划投资进度

受金融危机影响以及市场原因，出于保证每笔投资在最有效的时间内发生的目的，本公司主动调整了投资进度，2007-2009年各年分别实际完成项目总投资4,776.54万元，5,435.56万元和7,679.44万元，低于招股说明书披露的投资计划进度。

3、人民币升值

公司产品主要按美元计价外销，承诺效益预计美元对人民币汇率为8.021，而近两年人民币持续升值，2008、2009年末实际汇率分别为6.8346和6.8282。

4、贵金属价格上涨

近两年产品主要原材料金丝和铜价格大幅上涨，毛利率低于预期。

四、前次募集资金实际使用与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司2009年度报告信息披露情况对照如下：

单位：万元

序号	实际投资项目	截止2009年12月31日募集资金实际投资金额	公司2009年度报告信息披露募集资金投资金额	差异
1	高密度 IC 封装测试技术改造项目	10,921.52	10,921.52	0
2	功率 IC 封装测试技术改造项目	13,523.18	13,523.18	0
3	微型 IC 封装测试技术改造项目	4,368.36	4,368.36	0
4	技术中心扩建项目	1,639.05	1,639.05	0
5	超出募集资金补充流动资金	14,191.48	14,191.48	0
	合计	44,643.59	44,643.59	0

说明：公司2007年年报中披露的募集资金投资项目投入金额包括各项目实际支出金额和为开出设备信用证而转入保证金账户的金额；2008年将募集资金投资项目投入金额调整为各项目实际支出金额，不再包括开出设备信用证而转入保证金账户的金额，2008年度募集资金存放与使用情况专项报告对2007年度数据一并调整，调整后不存在差异。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2010年3月25日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 南通富士通微电子股份有限公司

截止日: 2009 年 12 月 31 日

货币单位: 人民币万元

募集资金总额 ^(注1)			56,434.48			已累计使用募集资金总额			44,643.59		
变更用途的募集资金总额			--			各年度使用募集资金总额			2007 年		19,357.40
变更用途的募集资金总额比例			--						2008 年		12,174.78
									2009 年		13,111.39
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完 工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额 ^(注2)	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 ^(注4)	实际投资 金额 ^(注5)	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额 ^(注6)		
1	高密度 IC 封装测试技术改造项目	高密度 IC 封装测试技术改造项目	13,020.00	13,020.00	10,921.52	13,020.00	11,126.00	10,921.52	204.48	100%	
2	功率 IC 封装测试技术改造项目	功率 IC 封装测试技术改造项目	19,173.00	19,173.00	13,523.18	19,173.00	13,153.00	13,523.18	-370.18	100%	
3	微型 IC 封装测试技术改造项目	微型 IC 封装测试技术改造项目	7,465.00	7,465.00	4,368.36	7,465.00	7,380.00	4,368.36	3,011.64	100%	
4	技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	2,585.00	2,585.00	1,639.05	2,585.00	1,777.00	1,639.05	137.95	100%	
5	超出募集资金补充流动资金	超出募集资金补充流动资金 ^(注3)	-	14,191.48	14,191.48	-	14,191.48	14,191.48	-		
合计			42,243.00	56,434.48	44,643.59	42,243.00	47,627.48	44,643.59	2,983.89		

- 注：1、募集资金总额中，不包括募集资金专户存款利息（扣除银行手续费）680.96 万元。
- 2、募集前承诺投资金额 42,243 万元，其中，固定资产投资 33,640 万元，流动资金投入 8,603 万元。
- 3、根据公司 2007 年 8 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》，本公司将实际募集资金净额超出募投项目投资总额（422,430,000 元人民币）部分的 141,914,800 元人民币用于补充公司流动资金。
- 4、本公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，对 2009-2010 年的预计年度投资计划进行了调整。
- 5、募投项目实际投资金额均为固定资金投资，不包括流动资金投入。
- 6、承诺投资额系设备采购合同总价，因设备采购主要为信用证方式付款，实际投入相比合同签订的时间一般滞后 3-6 个月。

公司董事会：

公司法定代表人：石明达

主管会计工作的公司负责人：章小平

公司会计机构负责人：王宏宇

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 南通富士通微电子股份有限公司

截止日: 2009 年 12 月 31 日

货币单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 ^(注 1)	承诺效益 ^(注 2)			最近三年实际效益 ^(注 3)			截止日累计实现效益	是否达到预计效益 ^(注 4)
序号	项目名称		2007 年	2008 年	2009 年	2007 年	2008 年	2009 年		
1	高密度 IC 封装测试技术改造项目	100%	267.76	1,438.26	1,590.99	-	1,442.54	1,521.77	2,964.31	否 (达成 89.91%)
2	功率 IC 封装测试技术改造项目	62%	196.95	1,766.31	2,588.01	-	535.86	614.99	1,150.85	否
3	微型 IC 封装测试技术改造项目	91%	150.96	903.47	1,082.13	-	145.76	877.26	1,023.02	否
4	技术中心扩建项目		未承诺效益	未承诺效益	未承诺效益					
	合计		615.67	4,108.05	5,261.14	-	2,124.16	3,014.02	5,138.18	

注: 1、截止日投资项目累计产能利用率: 是指投资项目达到预计可使用状态至本报告截止日期间, 投资项目的实际产量与招股说明书预计产量之比。

2、承诺效益: 系按本公司招股说明书披露的项目实施后新产品预计年销售收入乘以预计销售净利率、计划投资进度得出, 其中, 计划投资进度是根据招股说明书项目实施计划 (2007、2008 年分别投入 23,020 万元、19,223 万元), 自 2007 年 8 月募集资金到位后, 按项目分别计算各年投资平均占用额占项目总投资额的比例得出。

3、实际效益: 按投资项目固定资产投资后新增产品销售收入乘以当年实际平均销售净利率取得。

4、功率 IC 封装测试技术改造项目和微型 IC 封装测试技术改造项目累计实际效益未达到预计效益的 80%以上，原因如下：

（1）金融危机影响：受金融危机影响，近两年（尤其是 2008 年第四季度和 2009 年第一季度）集成电路终端消费市场需求低迷，行业增长放缓，市场竞争加剧，产品价格降低。同时，造成公司订单减少，募投项目产出低于预期。

（2）实际投资进度未达到计划投资进度：受金融危机影响以及市场原因，出于保证每笔投资在最有效的时间内发生的目的，本公司主动调整了投资进度，2007-2009 年各年分别实际完成项目总投资 4,776.54 万元，5,435.56 万元和 7,679.44 万元，低于招股说明书披露的投资计划进度。

（3）人民币升值：本公司产品主要按美元计价外销，承诺效益预计美元对人民币汇率为 8.021，而近两年人民币持续升值，2008、2009 年末实际汇率分别为 6.8346 和 6.8282。

（4）贵金属价格上涨：近两年产品主要原材料金丝和铜价格大幅上涨，毛利率低于预期。

公司董事会：

公司法定代表人：石明达

主管会计工作的公司负责人：章小平

公司会计机构负责人：王宏宇